

控股杭州众硅 “中微模式”或改写半导体设备市场格局

中经记者 顾梦轩 李正豪
广州 北京报道

市值超 1700 亿元的半导体设备龙头企业中微公司(688012.SH)在“平台化”战略道路上再进一步。近日,中微公司发布公告称,其正在筹划以发行股份方式购买杭州众硅电子科技有限公司(以下简称“杭州众硅”)的控股权,并募集配套资金。根据公告,公司股票自 2025 年 12 月 19 日开市起停牌,预计停牌时间不超过

10 个交易日。

就此,南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《中国经营报》记者采访时指出,中微公司收购杭州众硅,是半导体设备产业链整合的必然选择。刻蚀、薄膜沉积、CMP(Chemical Mechanical Polishing,化学机械抛光)并列半导体前道工艺三大核心设备,缺一不可。中微公司作为刻蚀设备龙头企业,通过收购填补湿法设备空白,实现“干法+湿法”完整覆盖,构建成套工艺解决方案,大幅提升客

户黏性与市场竞争力。这不仅及产品线的延伸,更是战略协同的深化,标志着中微公司正在推进从“单一设备供应商”向“平台型半导体设备企业”的关键转型。

值得一提的是,中微公司现任董事长尹志尧,是顶尖半导体专家,中国科学技术大学毕业的他,60 岁时创办中微公司,专注研发刻蚀设备。现如今,81 岁的尹志尧还长期奔波在一线,干劲十足,并持续推动公司进行平台化战略转型。

从“外部合作”到“内部协同”

“参股是第一步,控股才能实现全面整合,发挥战略协同效应。”

值得一提的是,此次收购前,中微公司就已经是杭州众硅的第二大股东,持股比例为 12.04%。2024 年 12 月,中微公司通过投资首次持股杭州众硅,并于 2025 年 9 月联合上海国投与孚腾资本等再次对其进行战略投资。截至此次公告发布,中微公司共持有杭州众硅 12.04% 股份。若此次交易完成,中微公司将实现对杭州众硅实现控股。

“参股是第一步,控股才能实现全面整合,发挥战略协同效应。”田利辉表示,前期(中微公司)参股(杭州众硅)已形成“风险可控的深度尽调”基础,大幅降低信息不对称与整合阻力,利于估值谈判与管理衔接,这是企业外延扩张的理性路径。从参股到控股,是战略深化的演进。进一步收购控股权,核心是掌握战略主导权——平台化战略需统一技术路线与资源配置,有控股权才能推动研发、销售体系深度融合,充分释放协同价值,避免战略分

歧,同时通过集中投入加速 CMP 设备的技术迭代与市场放量,提升投资回报率。此次收购将加速中微公司平台化战略落地,实现从“产品整合”到“生态整合”的跨越。

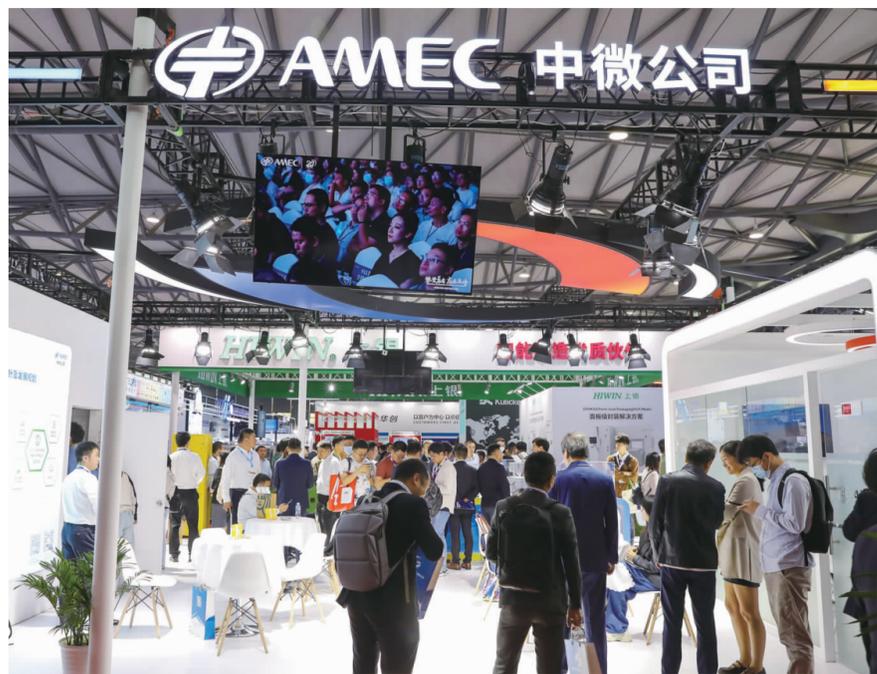
“从财务投资转向控股收购的核心动因,在于中微公司对湿法设备战略价值的重估。”张思远向记者指出,此前参股可能更多是财务投资或技术观察,而随着国内半导体设备国产化进入“全品类突破”阶段,CMP 设备的战略价值凸显。通过控股,中微公司可将杭州众硅的技术研发、市场拓展全面纳入集团战略体系,实现从“外部合作”到“内部协同”的升级,加速 CMP 设备的国产化进程。同时,实现控股后,杭州众硅的营收和利润将纳入中微公司合并报表,直接增厚公司业绩。

财报数据显示,2025 年前三季度,中微公司实现营业收入 80.63 亿元,同比增长约 46.40%。其中,

刻蚀设备收入 61.01 亿元,同比增长约 38.26%;LPCVD(低压化学气相沉积)和 ALD(原子层沉积)等薄膜设备收入 4.03 亿元,同比增长约 1332.69%。2025 年前三季度,中微公司实现归属于上市公司股东的净利润为 12.11 亿元,较去年同期增长约 32.66%。

高盛将中微公司 2026—2028 年营收预测上调 2%—3%,主要基于刻蚀和薄膜沉积设备收入增长,反映了客户对先进制程需求增加带来的产品组合升级趋势。

张思远向记者指出,LPCVD 和 ALD 设备收入同比激增 1332.69%,主要源于“低基数效应”与“需求放量”的叠加。2024 年同期中微公司该业务收入仅约 0.28 亿元,基数较低;2025 年随着国内 3DNAND、功率半导体等领域扩产,LPCVD 和 ALD 的需求快速释放。此外,中微公司的 LPCVD/ALD 设备已通过长江存储、合肥长鑫等头部客户验证,进入量产采购阶段,推动收入实现跨越式增长。



中微公司携公司最新产品亮相 2025 年中国国际半导体设备展。

视觉中国/图

快速切入 CMP 领域

中微公司收购杭州众硅的目的在于完善半导体设备产品线布局,填补湿法设备领域空白。

中微公司长期专注于刻蚀、薄膜沉积设备,是国内刻蚀设备的领军者。而标的公司杭州众硅则是一家从事 CMP 业务的公司。中微公司在公告中表示,通过本次并购,双方将形成显著的战略协同,同时标志着中微公司向“集团化”和“平台化”迈出关键的一步,符合公司通过内生发展与外延并购相结合、持续拓展集成电路覆盖领域的战略规划。

此次收购将给中微公司带来怎样的影响?苏商银行特约研究

员张思远向记者指出,中微公司收购杭州众硅的目的在于完善半导体设备产品线布局,填补湿法设备领域空白。随着国内晶圆厂加速向 14nm 及以下先进制程突破,CMP 设备的国产化需求迫切,而目前国内湿法设备市场主要由应用材料、泛林半导体等国际巨头主导,国产化率不足 10%。通过收购杭州众硅,中微公司可快速切入 CMP 领域,形成“干法+湿法”设备协同布局,覆盖半导体制造更完整的工艺环节。

对于此次收购的协同作用,

张思远表示:技术协同上,中微公司在等离子体技术、精密控制等领域的积累可与杭州众硅的 CMP 设备研发形成互补,加速湿法设备性能提升;客户协同上,中微公司已进入中芯国际、长江存储等主流晶圆厂供应链,杭州众硅可借助其渠道快速拓展市场,同时中微公司也能为客户提供“刻蚀+CMP+薄膜沉积”的一站式制程解决方案,增强客户黏性;供应链协同上,双方可共享核心零部件采购渠道,联合应对国际供应链风险,降低采购成本。

密集投资半导体产业链

“通过平台化整合,可提升客户黏性、降低研发成本、增强议价能力、拓展市场空间。”

正如中微公司在公告中指出,收购杭州众硅是公司向“集团化”和“平台化”转型的关键一步。记者注意到,近期,多家半导体上市公司开启“平台化”战略转型。“平台化”究竟将会带来怎样的影响?

田利辉向记者指出,平台化是国产半导体设备突破国际垄断的必然路径,核心优势在于一站式解决方案降低客户采购与验证成本,提升黏性;技术协同加速迭代,形成差异化竞争优势;规模效应摊薄研发成本,增强抗风险能力。

“通过平台化整合,可提升客户黏性、降低研发成本、增强议价能力、拓展市场空间。”田利辉说,此次收购是中微公司平台化战略的关键落子,补齐湿法设备最后一块核心拼图,实现“刻蚀—薄膜—CMP”前道工艺闭环,大幅提升竞争能力;同时强化客户价值,为先进制程提供全流程支持,加速向全球一流平台型企业迈进。

记者注意到,近年来,多家半导体上市公司背后频频出现中微公司的踪影。

早在 2015 年 12 月,中微公司与国家集成电路产业投资基金(大基金)、苏州聚源东方投资基金中心共同完成对拓荆科技(688072.SH)的投资,投资总额为 2.7 亿元。此后还先后完成对先锋精科(688605.SH)、珂玛科技(301611.SZ)、神州半导体等公司的投资。

田利辉向记者指出,中微公司这一系列投资并非简单的财务投资,而是一种以资本为纽带、构建产业生态护城河的“中微模式”。通过投资珂玛科技、拓荆科技(688072.SH)等产业链公司,中微公司实现了多重战略意图:一是洞察前沿技术趋势,进行前瞻布局;二是协同产业链,保障供应链安全;三是培育潜在的未来自来业务伙伴。这形成了一个以中微公司为核心的产业生态圈,可有效分散研发风险,强化产业链话语权,最终服务于其平台化发展的

终极目标。

而在中微公司半导体产业链生态闭环的战略布局中,半导体设备依赖“设备—零部件—材料”协同,投资产业链企业可保障供应链安全,降低外部依赖;同时通过股权绑定实现技术协同与信息共享,优先获取客户需求,反哺设备研发;此外,优质标的上市带来的资本增值可增厚利润,分散单一业务风险,同时汇聚行业人才,强化整体创新能力,契合国产替代背景下的产业集群发展逻辑。

广东更佳吴国际认证有限公司总经理李锦坤向记者指出,此举本质是“用资本换时间”。半导体设备验证周期长,被投资企业一旦上市,中微公司立刻拿到公开数据、共享测试平台,等于把客户产线前移 18 个月;同时以 5%—8% 股权锁定关键零部件厂,既降低成本又防“断供”。账面看是财务投资,实际是供应链外包的风险管理,把单一来源风险分散到资本市场,比自己建厂性价比更高。

银河通用获 3 亿美元融资 机器人赛道拥挤

中经记者 李昆昆 李正豪 北京报道

近日,银河通用机器人宣布已于近期完成新一轮超 3 亿美元融资,本轮融资由中国移动链长基金领投,中金资本、中科院基金、苏创投、央视融媒体基金、天奇股份等投资平台及产业巨头联合注资,并同步获得来自新加坡、中东的国际投资机构及老股东的注资。

《中国经营报》记者就融资及公司发展规划等事宜采访银河通用机器人方面,截至发稿前,对方尚未回复。

经济学家余丰慧告诉记者,银河通用机器人在行业中具有一定的技术优势,特别是在智能控制和自主学习算法方面表现突出。其采用的最新一代人工智能芯片使其运算速度和处理能力超过同类产品,能够更高效地执行复杂任务。此外,银河通用机器人拥有丰富的传感器系统,使其在环境感知和交互体验上更为精准流畅。然而,与国际顶尖同行相比,银河通用机器人在品牌影响力和市场份额方面仍有提升空间,并且在高端定制化服务方面还需进一步强化以满足特定用户的需求。

优势与劣势

据了解,银河通用机器人成立于 2023 年 5 月,由王鹤博士与姚腾洲联合创立,核心产品为 Galbot G1 机器人,已应用于零售、工业、医疗等领域。

银河通用机器人官方介绍,在家居空间里,它能够完成清洁打扫、有序整理、准确寻找物品以及拿取快递等工作,致力于让人们居家生活更舒适惬意。

在零售商超领域,它能够持续进行高效的货物盘点与补货工作,

还能迅速而准确地完成送货任务,为顾客提供及时、便捷的购物体验。银河通用开创城市级具身智能解决方案“银河太空舱”,以人形机器人 Galbot 为核心,实现完全自主的运营与值守,打造人与机器人“零距离”交互的智慧零售与城市服务终端。

据介绍,在工厂环境中,Galbot 具备对零件进行分类和包装的强大能力,能够精准抓取任何材质和形状的零件。公司已与宁德时代、

博世集团、丰田汽车、韩国现代、北汽集团、上汽集团、极氪汽车、长城汽车等企业达成深度合作,实现人形机器人进厂真实自主干活,累计订单规模已达数千台。

在药店场景中,Galbot 可以全天候待命,随时执行药品运送及库存管理任务,尤其在夜间,能够发挥不可或缺的关键作用,确保药品供应的及时性和准确性。2024 年年底,银河通用机器人与爱博医疗联合推出全国首家 24 小时智慧医

疗门店,引入银河通用人形机器人实现全自主运营,实现具身智能即时零售的可复制、可推广的规模化解决方案。

在模型方面,前不久,银河通用推出全球首个跨本体、全域环视的导航基座大模型 NavFoM,让机器人第一次理解“移动的本质”,实现在复杂场景下跟随及自主导航两种能力,并在业内率先突破小时级长程导航,并能实现动态避障。

与此同时,银河通用还推出灵

巧手神经动力学模型 DexNDM,突破传统轨迹编程的技术,在行业内首次打造基于训练的灵巧手控制算法,使灵巧手能真正灵活应对复杂、多样、极小、极小的物品实现手内旋转精密操作,推动具身智能赋能万亿元规模的工业精密应用市场。

一位知名 VC 掌门人则指出,今年国内具身机器人赛道的创业公司数量已经超过 150 家。如何在众多机器人公司中脱颖而出,是银河通用机器人面临的一大难题。

未来发展

业内人士表示,目前具身智能行业面临的挑战主要在于投资人对短期成果的急切期待与技术实现落地所需的较长周期之间存在冲突。人们往往过度关注技术短期内的变革,却低估了其长远发展潜力。具身智能行业需要耐心,需要有长期投资意愿的资金注入。

银河通用创始人王鹤曾在今年接受媒体采访时表示,今年以来,机器人企业在两种能力的选择上逐步有了区分度:一类以宇树科技为代表,其机器人擅长运动、舞

蹈、拳击,特点是以腿足乃至全身控制为主,能展现出精彩的运动能力。还有一类是以银河通用为代表的“干活派”,依靠视觉反馈闭环,展现出在实际场景中干活的“干活派”里,大致还可分为视觉算法+轨迹生成,与端到端 VLA(即视觉—运动—动作一体化生成)两种技术路径。

2025 年年初,银河通用以 10 亿级合成大数据,端到端训练了一个 VLA 大模型,以视觉作为输入,模型实时输出,指挥机器人末端执

行器移动,是一个闭环反馈模型,能够实现对不同场景中移动物体的抓取。6 月,其又推出了端到端导航大模型,使机器人能够拥有“听—看—懂—走”闭环运动能力。

余丰慧表示,看好银河通用机器人未来的发展,主要基于以下几点原因:首先,随着工业 4.0 的到来,市场对自动化和智能化设备的需求日益增长,为银河通用机器人的发展提供了广阔的市场前景。其次,该公司持续加大研发投入,不断推出创新产品和技术,有助于

保持行业领先地位。最后,银河通用机器人已经建立了较为完善的产业链布局,具备从研发到生产的全方位能力,这为其长期稳定发展奠定了坚实基础。因此,只要能有效解决现存挑战并抓住机遇,银河通用机器人有望在未来实现更大的突破和发展。

王鹤认为,现有的模型架构不能说完全成熟,但是够用了。模型方面一直有进展,但起决定性作用的是数据。在数据足够的情况下,好的模型能学得更好,但数据不够

时,好的模型也会变成“差生”。好比教一个三岁小孩学围棋,一上来就教高端技巧并不现实,得先让他知道什么是黑子和白子。

他还说,可批量复制的场景落地,将是具身智能的“生死分水岭”。在王鹤看来,未来三年左右,能找到可以落地的场景就能留在牌桌,找不到的将会出局。未来一年,如果能实现千台到万台的机器人批量交付,行业价值才算得到验证,具身智能的泡沫也将被剥离。